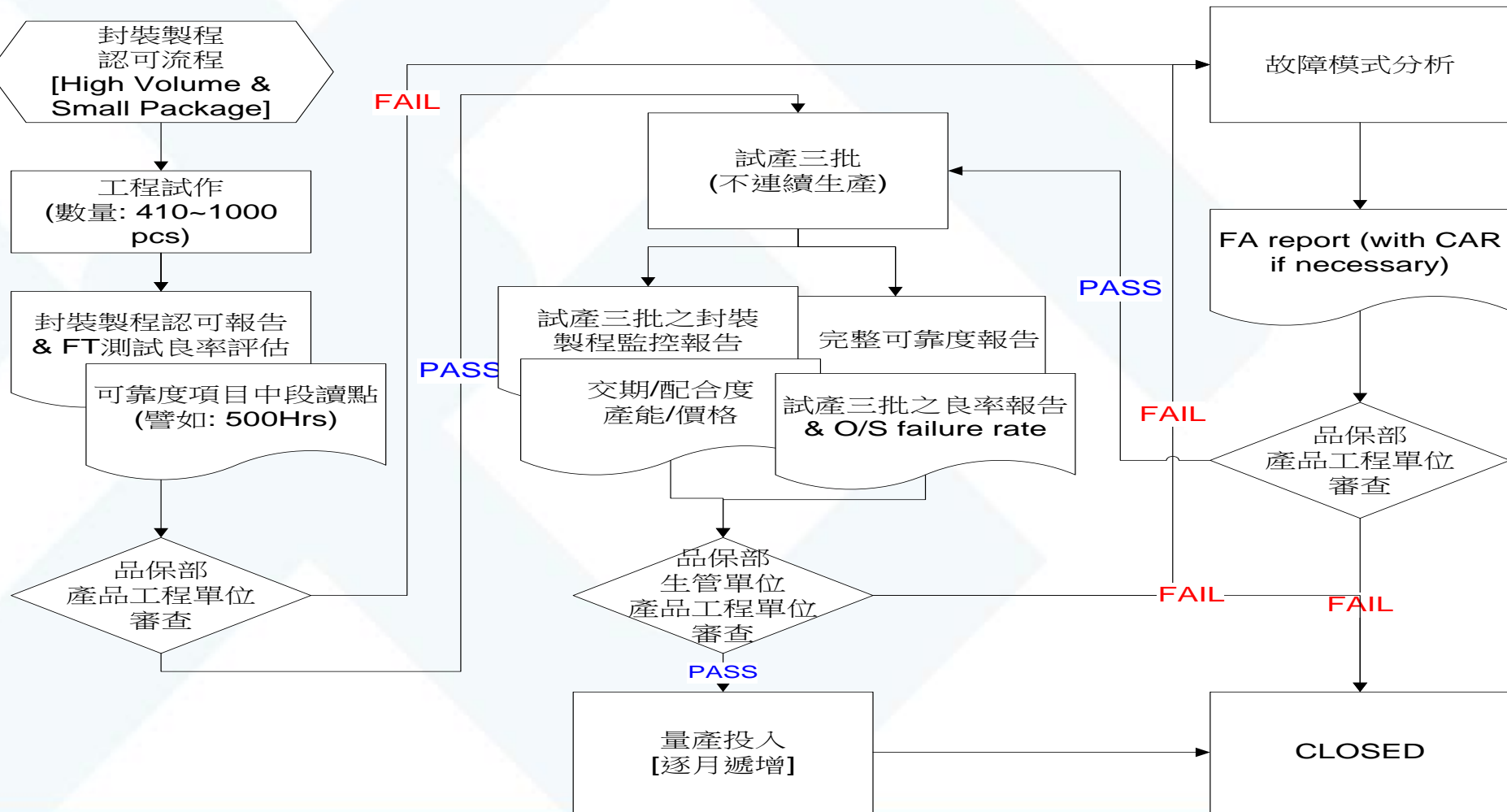


供應商相關：生產製程確認與監控

專業的產品封裝/測試生產製程確認與管控：

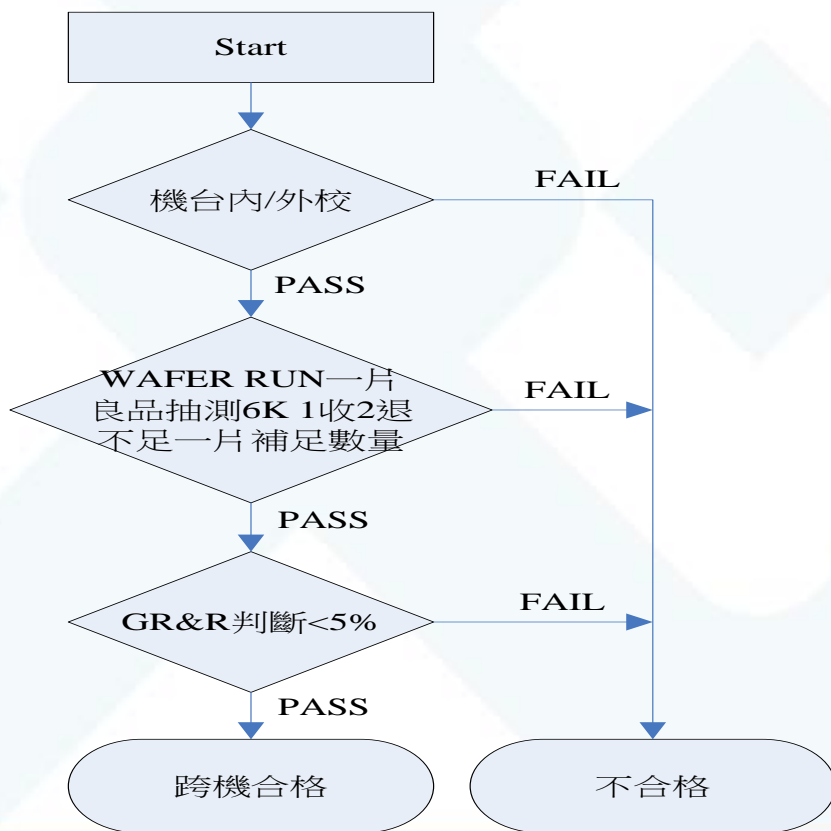
- ◆ 晶片封裝製程認可程序
- ◆ 晶片測試認可程序
- ◆ 供應商的質量監控 & 定期評核
- 目的：提供質量一致性高、穩定性佳的產品給客戶，幫助客戶生產順利、提高良率與直通率。

晶片封裝製程認可程序

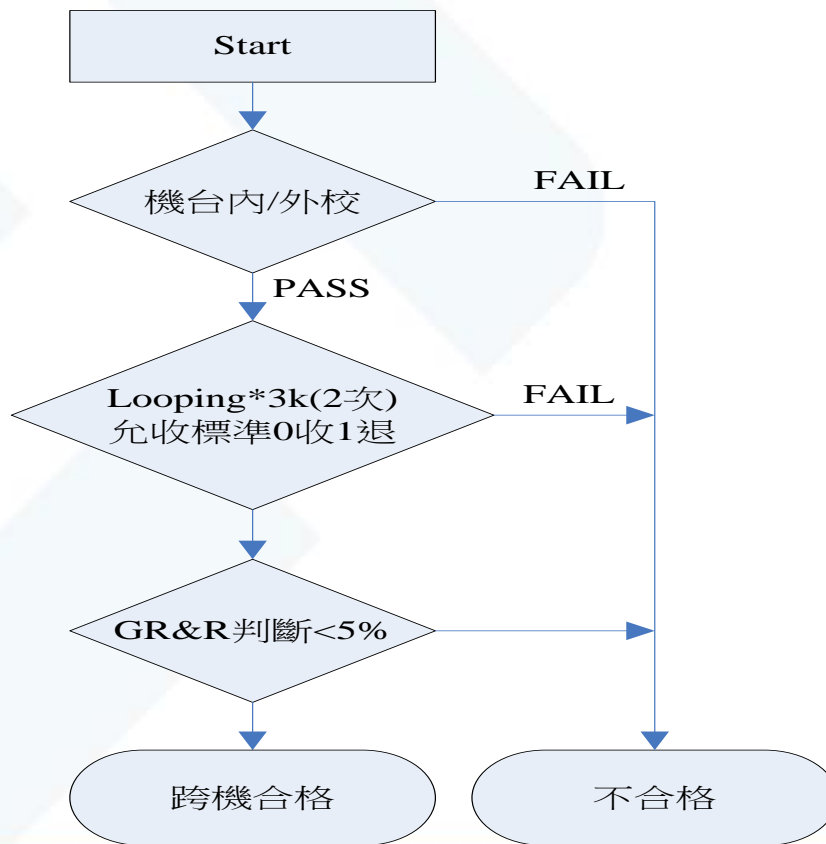


晶片測試認可程序

◆ CP (Circuit Probing) Test Equipment Qualification



◆ FT (Final Test) Test Equipment Qualification



廠商的質量監控&定期評核-1

1. 廠商的質量監控：

◆ 晶圓生產製程質量指標

- ◆ 重要製程參數之製程能力值(CPK)趨勢
- ◆ 製程特性電性檢測(PCM/WAT)項目&(CPK)趨勢

◆ 封裝生產製程質量指標

- ◆ 主要製程管制參數之製程能力值(CPK)趨勢
- ◆ 主要封裝 QC gate 缺點比率(DPPM)、批退率(LRR)統計，及柏拉圖分析

◆ 測試生產製程質量指標

- ◆ 導入量測系統分析(MSA)概念，對產品特性的關鍵參數，以GR&R < 5%為允收規格，以判斷測試機台之穩定度
- ◆ 針對產品特性的關鍵參數，利用管制圖(SPC)，管制機台穩定度
- ◆ FT 測試EQC每批檢視，加上月PPM/LRR 趨勢圖分析
- ◆ 測試彎腳不良/IC loss/正印不良缺點比率(DPPM)每批檢視，輔以月PPM/LRR 趨勢圖分析

廠商的質量監控&定期評核-2

1. 廠商的質量監控(續)：

◆ 紘康科技進貨品質抽驗統計分析：

- ◆ 每月以批退率(LRR)分析與趨勢圖，分析各供應商的品質趨勢

◆ 產品良率統計分析：

- ◆ 每月對主要產品之生產良率以批/月良率趨勢圖分析，輔以柏拉圖分析主缺點比率 (TOP DPPM)

2. 廠商(供應商、外包商)的定期評核：

評核之權值比例為：

- ◆ 品保部門：品質 = 40%
- ◆ 採購/生管單位：交期 = 30%
- ◆ 產品工程單位：協調性/服務性 = 30%

參考文件：廠商管理暨原物料驗證作業程序